

株式会社東京精密 2024 年度(2025 年 3 月期) 決算説明会
質疑応答 要約

2025 年 5 月 9 日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された 2024 年度(2025 年 3 月期) 決算説明会(Web 開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
- 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

【質疑応答：2024 年度業績説明、2025 年度業績予想】

1. 生成 AI に関する数字を整理してほしい。

- 説明会資料に記載の通り、今後、「生成 AI を含む HPC 関連」という表現で説明したい。これは、当社の製品の仕様上、生成 AI 向けと断定することが困難であることや、HPC 関連需要の区分が難しいためであり、ご理解いただきたい。
- その上で、「生成 AI を含む HPC 関連」の実績・見込は以下となる。
 - 2024 年度下期・受注高：2024 年度上期比+160%で、2 月想定(同+50%)を大幅に上回り、SPE 受注高の 3 割半ばとなった。ロジック系と HBM 向けそれぞれが想定を上回ったほか、OSAT からの引合が増加したことも寄与した。
 - 2024 年度下期・売上高：同+65%となり、2 月想定(同+20%)を上回り、SPE 売上高の 2 割程度となった。
 - 2025 年度上期・受注高見通し：2024 年度下期実績比で、+1 桁%を想定しており、これは上期の SPE 受注高見通しの 3 割程度に相当する。
 - 2025 年度上期・売上高見通し：同 +30%程度の増加を想定しており、これは上期の SPE 売上高見通しの 2 割半ばに相当する。
 - 2025 年度下期の見通し：現時点で SPE の売上高予想を 上期と同額と設定していることで、ご理解いただきたい。もっとも、納入予定が確定していない商談もあり、これらは今後の SPE 売上予想の変動要因になる。

2. 「生成 AI を含む HPC」の需要が想定以上だったにも関わらず、1-3 月期の SPE 受注高が、10-12 月期比で減少、想定を下振れた背景を確認したい。

- まず、1-3 月期に、受注残高のうち当面の売上実現性が低いと判断したものを、約 20 億円整理しており、その結果、受注高が同額減少している。
- また民生エレクトロニクス、パワー半導体(特に SiC 関連)需要は弱含んでいる。相対的に堅調な中国にサプライチェーンが移っていることも要因と考えている。

3. 米国関税政策の影響について、直接・間接的な影響が出ていれば伺いたい。

- 当社も比率は小さいが米国向けの直接取引があり、その場合、米国顧客が関税を負担する。当社の製品が米国企業と競合することはほとんど無いため、商談自体への影響は少ないと思われるが、関税負担が高額となることで顧客が発注を躊躇するケースが考えられる。
- 一方で、関税政策の影響が大きいと考えていた、中国顧客からの引合いに減速の兆候は見られない。これが、2025 年度上期 SPE 受注予想を 2024 年度下期比で増加と見積もる背景の一つになっている。

4. 2025 年度業績予想について、増収幅(前期比 85 億円増)に対し、営業利益の増加(同 13 億円増)が限定的と想定する背景を伺いたい。

- プローバなどを中心に、調達部材の価格が上昇していることや、高精度温度制御の需要増加にあたり、高精度な部品の搭載量が増えていることが要因の一つ。原価低減の余地はあると考えるが、一定程度保守的に予想している。
- また計測では、充放電試験システム事業の機器販売が増加する前提だが、コスト低減が道半ばであり、想定に達していない。これも改善余地はあると考える。
- また、研究開発費・減価償却費とも、前期比増加の予想であることに加え、販管費は計画を満額使用する前提で業績予想を策定している。
- SPE の四半期営業利益率は、売上増加時には既に 20%半ばになっていることを踏まえても、今後利益率を改善させる余地は十分あると考えている。

【質疑応答：2025 年度- 2027 年度 中期経営計画】

5. SPE の売上高目標 1,400 億円に向けた成長ファクターを確認したい。また、営業利益率目標(24%)は強気に見えるが、達成の蓋然性を伺いたい。

- まず生成 AI を含む HPC の需要は大きく伸びると考えている。
- 例えば、プロローバは、デバイス種別を問わず、テスト時の発熱量増加により、プロローバの高精度温度制御の要求が拡大するとみている。
- また、NAND、HBM へハイブリッドボンディングの適用が進むと考えており、当社の事業機会となる。現時点では、これらの投資が 2026 年度に始まると考えている。この領域でのシェア拡大にも期待している。
- また、長期的にエッジ AI が、民生エレクトロニクスに採用されることで、市場は大幅に拡大すると想定している。
- 長期的には、当社の SPE 売上において、これらの生成 AI を含む HPC 需要が過半になる可能性も否定しない。
- また、パワー半導体やアナログ半導体についても、一定の成長が実現するとの前

提で計画を作成している。さらに CMP を中心に、化合物半導体(GaN 等)向けや、PLP 基板関連需要も拡大すると想定している。

- また、四半期営業利益率が売上増加時に計画の水準に達しており、蓋然性はあると考えている。

6. 前回中期経営計画の未達要因として、民生需要の伸び悩みを挙げたが、自社要因による未達部分はあるのか。

- 売上高の未達は、民生需要の伸び悩みが最大の要因と考えている。
- 利益面の未達は、売上高の未達に加え、部材価格、外注加工費、輸送費等の上昇に対し、当社の原価低減努力が追い付かなかったことも要因と考えている。

7. 売上高目標 1,700 億円を、保守的と見る向きもある。この点はどう考えるか。

- 前回中期経営計画で売上高が計画未達になったことを踏まえ、蓋然性のある数字として設定している。当社としては、そう遠くない時期に売上高 2,000 億円規模への成長を実現したいという思いを持っている。

8. 大型 PLP を成長機会の一つとして掲げているが、時間軸から考えると当中期経営計画期間と一致しないのではないか。

- 足許では、大型ではないが、300 mm 角などで一定の需要があり、これらを勘案して成長機会の一つとして組み入れている。

9. ROE 目標(15%)を、前回中期経営計画から据え置いている背景を確認したい。

- 必達目標として設定したことによる。

10. 中期経営計画期間の設備投資計画として、八王子新工場を挙げている。詳細を聞きたい。

- 今年度に東京都八王子市内で 1 万坪弱の用地を取得する。
- 今後、大型装置の需要が増える局面にあっても柔軟に対応できることや、当社の強みである内製化を強化するための工作機械の導入など、さまざまな可能性を想定し、用地取得の判断をした。

以上